福田英才荟集成电路研发人才奖励申请指南

一、编制依据

《关于实施福田英才荟政策的若干措施（2025）》以及《福田区重点行业人才支持与认定办法》。

二、政策内容

近三年集成电路类机构承担市级以上项目或上年度研发投入占营收15%以上的，给予芯片设计、流片、高端封测、软件算法及化合物半导体等研发团队最高30万元奖励。同一家科研机构一年内最多申报3人。

三、申报对象及条件

（一）申请人所在单位的条件

1、申请人所在企业（机构）原则上应为在福田区依法实际经营的独立法人企业（机构）。

2、 申请人所在企业（机构）应以半导体器件的设计、制造、封装、测试，以及相关原材料、辅助材料、装备等为主营业务。

3、近三年（含当年）企业承担深圳市及以上集成电路相关项目，或上年度研发投入占营收15%以上。

（二）申请人的条件

1、申请人属于所在企业的化合物半导体研发、芯片设计、流片工艺、软件算法或封测技术科研团队成员。

2、申请人须在福田区连续缴纳个人所得税或社会保险1年以上，诚信守法，无违法犯罪和不良记录。

四、支持事项

同一个项目符合以下多个条件的，按从优不重复原则予以支持。

（一）承担市级以上集成电路相关项目（同一项目不得重复申请奖励）

1、承担深圳市级集成电路项目并已获得资金资助1个及以上的，最多可申报1人，人才奖励10万元/人。其中市级项目包括：深圳市科技创新局的集成电路相关项目、深圳市工业和信息化局的集成电路专项扶持计划、深圳市发展和改革委员会的集成电路相关项目。

2、承担广东省级集成电路项目并已获得资金资助1个的，最多可申报1人。承担广东省级集成电路项目并已获得资金资助2个及以上的，最多可申报2人。人才奖励10万元/人。

3、承担国家级集成电路1个并已获得资金资助的，最多可申报2人。承担国家级集成电路2个及以上并已获得资金资助的，最多可申报3人。人才奖励10万元/人。

（二）研发投入占营收比例

1、研发投入额500万元（含）-5000万元，研发投入占营收比例达15%以上，人才奖励10万元/人。最多可申报1人。

2、研发投入额5000万元（含）-1亿元，研发投入占营收比例达15%以上，人才奖励10万元/人。最多可申报2人。

3、研发投入额1亿元及以上，研发投入占营收比例达15%以上，人才奖励10万元/人。最多可申报3人。

五、申请材料

（一）基础材料（所有项目都要提供）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **材料形式** | **备注** |
| 1 | 福田英才荟集成电路研发人才奖励申请表(附件1） | 原件（签字盖章） | 申请材料需全部上传电子文档（命名与材料名称一致） |
| 2 | 申请单位证照（“三证合一”营业执照） | 验原件交复印件（盖公章） |
| 3 | 税务部门出具的申请企业上一年度在福田纳税证明 | 原件（盖章） |
| 4 | 申请人身份证（港澳台提供港澳台通行证，外籍人士提供护照) | 验原件交复印件（盖公章） |
| 5 | 申请人在申请单位近一年的社保清单或个税清单 | 原件（盖章） |
| 6 | 申请对象的银行卡正反面复印件  （复印件上需手抄开户行、银行账号） | 复印件（盖章） |
| 7 | 申请人的在职证明材料，含所在科研团队的工作内容介绍。 | 原件（盖章） |

（二）专项材料（针对申报项目提供）

1、承担市级以上集成电路相关项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **材料形式** | **备注** |
| 1 | 项目证明（项目合同、项目任务书或其他证明材料）及资金到账证明材料。 | 复印件（盖章） | 申请材料需全部上传电子文档（命名与材料名称一致） |

2、研发投入占营收比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **材料形式** | **备注** |
| 1 | 上一年度企业所得税年度纳税申报表 | 复印件（盖章） | 申请材料需全部上传电子文档（命名与材料名称一致） |

六、办理流程

（一）网上申请。申请人在福田区企业服务平台（https://qfzx.szft.gov.cn）注册、提交申请并上传相关资料。

（二）预审。福田区科技和工业信息化局根据申请人提交的材料进行预审。

（三）材料提交。在网上申请并接到预审通过短信通知后，将纸质材料提交至福田区行政服务大厅综合窗口。

（四）审核确认。由福田区科技和工业信息化局负责审核。

（五）公示。对审核通过的申请项目，在福田政府在线网站公示5个工作日。

（六）拨款。对公示后无异议或异议不成立的申请对象，按照规定对审核通过的项目发放资金。

七、办理时间及地点

（一）递交材料地址：福田区政务服务大厅（深南大道1006号福田区国际创新中心F座3层）

（二）受理时间：2025年5月20日-2025年8月20日

八、咨询电话

福田区科技和工业信息化局，0755-23949461。

九、其他

（一）本指南政策项目资金量受本年度财政预算安排总量的控制和调整，且本指南所指支持资金为税前金额。

（二）申报单位及申报人对申报材料的真实性和准确性负责，如果出现弄虚作假及其它违规申报行为，追回本政策支持资金，单位及个人五年内不得申报福田区人才政策支持。触犯法律的，移交有权部门，依法追究法律责任。

（三）本指南由福田区科技和工业信息化局负责解释。根据实际工作需要，福田区科技和工业信息化局有权对本指南部分内容进行修订，并及时向社会公布。

（四）本指南有效期为自印发之日起，至2025年12月31日止。

附件1：

福田英才荟集成电路研发人才奖励申请表

申请人所在单位：xx公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人姓名 | *张三* | 出生年月 | *1978.01* |
| 性别 | *男* | 政治面貌 | *中共党员* |
| 学历 | *本科* | 毕业院校 | *ΧΧ大学* |
| 开户行 | *中国银行xx支行* | 银行卡号 | *6210 0000 0000 0000* |
| 职务 | *董事长* | 联系方式 | 办公电话：0755-12345678  手 机：13012345678 |
| 经办人姓名 | *张三/李四* | 联系方式 | 办公电话：*0755-12345678*  手 机：*13012345678* |
| 申请项目 | 🞎承担市级及以上相关项目  🞎研发投入占营收比例 | | |
| 项目（团队）中承担主要工作及成就 | 1. *承担重大项目情况及发挥作用；2、个人获得职称、专利、论文、奖项等情况；3、其他个人成就；4、不少于500字）* | | |
| 申请人通讯地址 | *深圳市ΧΧ区ΧΧ街道ΧΧΧΧ* | | |
| 单 位 推 荐 理 由 |  | | |
| **声明：本单位及申报者对申报材料真实性、完整性负责，并承诺无犯罪和恶意欠薪等严重违法行为，否则取消人才待遇，退回已获资金，5年内不得申请福田区人才政策支持。**  申请人（签字，手印）：日期： 年月日  申请人所在单位（盖章）： 日期： 年月日 | | | |

附件2：

（请用公司信笺纸或有公司LOGO的纸张，此行无需打印）

在职证明

兹证明ΧΧΧ（身份证号：ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ）于ΧΧΧ年起在公司任职ΧΧΧΧ（此处注明申请人在公司所任的职务）至今，是公司XX团队成员，具体承担ΧΧΧΧ技术研发（ΧΧΧΧ项目转化等）。

特此证明。

法定代表人（授权人）签字：

ΧΧΧ公司

ΧΧΧ年Χ月Χ日

（注明单位名称和时间，并加盖公章）

附件3

奖励人员信息汇总表

**依托申报单位全称（盖公章）:**xx公司全称 **统一社会信用代码： 填报日期：x年x月x日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **国籍** | **证件类型** | **证件号码** | **职位** | **银行卡开户银行** | **银行账号** | **申请人手机号（通知信息）** | **本人签名（按手印）** |
| 例子 | 李三 | 男 | 中国 | 身份证/护照/港澳通行证 | 123456.... | 总经理 | (精确到分行或支行) | 620xxxxx | 159... | 李三（按指模） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**单位经办人：xx 经办人手机：xxxx（手机号码）**

**注：1.请同时上传WORD版和PDF盖章签名版本。**

**2.请据实严格按例子格式上传，否则不予以通过审核。**